



## 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年11月12日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス  
コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186

四半期報告書提出予定日 2021年11月12日 配当支払開始予定日 2021年12月9日

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有

四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨)

### 1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年9月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第2四半期	59,826	43.8	10,733	174.3	12,493	342.3	17,268	—
2021年3月期第2四半期	41,595	△0.6	3,913	9.7	2,824	14.3	70	△95.4

(注) 包括利益 2022年3月期第2四半期 22,819百万円 (—%) 2021年3月期第2四半期 △169百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第2四半期	460.57	417.89
2021年3月期第2四半期	1.91	1.73

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2022年3月期第2四半期	227,405	124,880	43.1	2,521.86
2021年3月期	177,189	78,239	37.9	1,803.03

(参考) 自己資本 2022年3月期第2四半期 98,003百万円 2021年3月期 67,093百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期	—	12.00	—	18.00	30.00
2022年3月期	—	23.00	—	—	—
2022年3月期（予想）	—	—	—	23.00	46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

2021年3月期期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 記念配当 4円00銭

2022年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

2022年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	125,000	36.9	22,500	133.4	23,500	185.6	23,500	183.8	604.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社（社名）ー、除外 ー社（社名）ー

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有  
（注）詳細は、添付資料10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2022年3月期2Q	38,955,486株	2021年3月期	37,305,202株
② 期末自己株式数	2022年3月期2Q	93,852株	2021年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2022年3月期2Q	37,494,517株	2021年3月期2Q	37,123,019株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）は、2021年11月30日に質疑応答を主目的としたオンライン（WEB）での開催を予定しております。

決算説明資料については、2021年11月29日に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	10
(継続企業の前提に関する注記) .....	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) .....	10
(会計方針の変更) .....	11
(セグメント情報等) .....	12

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済は新型コロナのワクチン接種が進み感染者数が減少に転じ、経済活動は正常化に向かっており、雇用者数の増加や物価上昇の報道がなされています。中国経済は、既に経済活動が正常化され、景気は上向いており一定の経済成長を維持しています。我国では、度重なる緊急事態宣言等の発出により、商業活動等に影響が出ております。感染者数は減少傾向にあるものの、景気回復には時間を要する経済状況が続いております。為替相場は、円安方向で推移しました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、世界的なリモートワークの浸透に伴い、企業や学校でのWEB会議システムの普及拡大により、パソコンやデータセンター用サーバーなどの需要が増加したため、メモリなど半導体デバイスの需要が旺盛であり一部では品不足となりました。東南アジア地区での新型コロナ感染症の影響も加わり、サプライチェーンに混乱を招いたため、産業用機器や自動車、家電製品に至るまで半導体等電子部品の供給が滞る事態となりました。デバイスメーカー各社は設備投資の前倒しを決め、保有する製造設備の稼働率も高水準な状況となりました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの真空部品や半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）の販売は、顧客からの引合いが強く堅調に推移し前年を上回りました。特にシリコンパーツは、半導体プロセスの微細化が進むなかシリコンウエーハと熱膨張係数が同一で高純度なシリコン製部材への切り替え需要が急速に高まっており、当社は、旺盛な顧客需要に対応した積極的な設備投資および研究開発投資を行うことが、中長期的に企業価値を高められると判断し、同製品製造子会社において約51億円の第三者割当増資を行うことを決定しました（2021年8月6日及び2021年9月24日公表の「半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」をご参照ください）。

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けが軟調でしたが、5G通信システム機器向けやPCR検査装置など医療検査機器向けのほか、半導体分野も堅調に推移し、前年を大きく上回りました。また、成長著しいパワー半導体用基板は、IGBT向けDCB基板の増産、新製品であるAMB基板の採用が増えたことから、売上は大きく伸ばしました。同製品を取扱う中国子会社は、さらなる生産ラインの拡大に加え、基板周辺の研究開発強化を目的に約75.7億円の第三者割当増資を行うことを決定しました（2021年8月6日及び2021年9月24日公表の「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」をご参照下さい）。

また、中国で展開している持分法適用会社である半導体ウエーハ製造会社の追加設備投資を実行するため、同社株式を現地の投資基金等に対し、第2回目の第三者割当増資を行った結果、持分変動利益（特別利益）93億円が発生しております。

尚、為替の影響につきましては、15億円の為替差益となりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は59,826百万円（前年同期比43.8%増）、営業利益は10,733百万円（前年同期比174.3%増）、経常利益は12,493百万円（前年同期比342.3%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は17,268百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益70百万円）となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

#### (半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

世界的なリモートワークの拡大に伴いスマートフォンやパソコン、データサーバー等の需要増加により、電子部品の需給は依然ひっ迫しております。半導体不足から各種産業への影響も出始めており、半導体デバイスメーカーや素材メーカー各社は増産体制構築の計画を発表しております。

当社グループが供給する半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）は、デバイスメーカーの稼働率が高水準であることや半導体プロセス微細化の進行などから、当社グループの顧客である半導体製造装置メーカーからの受注は好調に推移し、売上は前年を上回りました。顧客のご要望からシリコンパーツ増産のため、中国国内において第三者割当による資金調達を行い設備投資に充当する予定です。また、液晶や半導体製造装置などの部品洗浄サービスも需要増加により売上を伸ばしております。

当該事業の製品は、半導体製造装置等の設備投資および設備稼働率に影響を受けます。

この結果、当該事業の売上高は35,895百万円（前年同期比24.7%増）、営業利益は7,104百万円（前年同期比226.3%増）となりました。

## (電子デバイス事業)

主力のサーモモジュールは、5G用の移動通信システム機器向けやPCR等の医療検査装置向けは安定した販売を継続しております。美容家電を含む民生分野向け、半導体装置向けは計画を上回る水準で推移しました。自動車温調シート向けは、世界各国の自動車販売の影響により弱含みの展開で推移しました。新たに自動運転に使用される自動車レーダー用途に参入しました。

パワー半導体用基板は、IGBT向けDCB基板が需要回復により増産傾向となり、車載向けのAMB基板は量産が進み伸びました。当該製品は前年比で倍増の売上となり、需要が強く今後の成長が見込めるため、中国国内において第三者割当による資金調達を行い設備投資ならびに研究開発費用に充当する予定です。磁性流体は、スピーカー向けとスマートフォンのバイブレーションモーター用途は一定水準で推移しました。

当該事業の製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。

この結果、当該事業の売上高は12,213百万円（前年同期比71.6%増）、営業利益は3,052百万円（前年同期比63.4%増）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## ①資産、負債及び純資産の状況

## &lt;資産&gt;

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ50,216百万円増加し、227,405百万円となりました。これは主に現金及び預金18,007百万円、有形固定資産13,652百万円、関係会社株式10,129百万円の増加によるものであります。

## &lt;負債&gt;

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ3,575百万円増加し、102,525百万円となりました。これは主に社債（1年内償還予定を含む）1,434百万円、転換社債型新株予約権付社債1,448百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）1,726百万円の減少があった一方、支払手形及び買掛金1,421百万円、電子記録債務3,846百万円、その他固定負債1,295百万円の増加によるものであります。

## &lt;純資産&gt;

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ46,640百万円増加し、124,880百万円となりました。これは主に資本剰余金8,945百万円、利益剰余金16,598百万円、非支配株主持分15,759百万円の増加によるものであります。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ18,007百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には48,210百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

## &lt;営業活動によるキャッシュ・フロー&gt;

営業活動の結果得られた資金は6,369百万円（前年同期比840百万円増）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益20,670百万円、減価償却費3,771百万円によるものであります。支出の主な内訳は、持分変動利益9,327百万円、売上債権の増加額2,737百万円、棚卸資産の増加額3,523百万円によるものであります。

## &lt;投資活動によるキャッシュ・フロー&gt;

投資活動の結果使用した資金は8,226百万円（前年同期比1,740百万円減）となりました。収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入5,517百万円によるものであります。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出13,814百万円によるものであります。

## &lt;財務活動によるキャッシュ・フロー&gt;

財務活動の結果得られた資金は18,274百万円（前年同期比2,400百万円増）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,707百万円、非支配株主からの払込みによる収入22,181百万円によるものであります。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出3,666百万円、社債の償還による支出1,434百万円によるものであります。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年8月13日の「2022年3月期 第1四半期決算短信」で公表いたしました業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	30,202,819	48,210,012
受取手形及び売掛金	32,201,188	—
受取手形、売掛金及び契約資産	—	37,754,511
商品及び製品	5,381,026	6,186,139
仕掛品	5,064,821	6,453,749
原材料及び貯蔵品	6,680,313	9,158,579
その他	9,190,888	9,207,881
貸倒引当金	△643,491	△716,234
流動資産合計	88,077,566	116,254,639
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	15,446,974	16,845,962
機械装置及び運搬具(純額)	14,963,909	17,403,727
工具、器具及び備品(純額)	4,693,247	4,741,316
土地	1,893,760	1,895,889
リース資産(純額)	3,324,427	3,730,122
建設仮勘定	12,720,925	22,078,914
有形固定資産合計	53,043,245	66,695,933
無形固定資産		
のれん	576,285	517,646
その他	1,238,014	1,278,458
無形固定資産合計	1,814,299	1,796,104
投資その他の資産		
関係会社株式	23,317,126	33,446,245
その他	11,520,121	9,836,799
貸倒引当金	△582,712	△623,930
投資その他の資産合計	34,254,535	42,659,115
固定資産合計	89,112,080	111,151,153
資産合計	177,189,647	227,405,793

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,012,643	21,433,675
電子記録債務	257,015	4,103,925
短期借入金	5,426,689	5,769,117
1年内償還予定の社債	5,468,000	5,468,000
1年内返済予定の長期借入金	6,513,161	5,906,739
未払法人税等	1,289,763	1,725,531
賞与引当金	990,470	1,226,072
その他	18,932,476	19,557,255
流動負債合計	58,890,220	65,190,317
固定負債		
社債	11,464,000	10,030,000
転換社債型新株予約権付社債	3,734,976	2,286,720
長期借入金	15,023,494	13,902,963
退職給付に係る負債	536,832	537,666
役員退職慰労引当金	18,300	—
資産除去債務	140,533	141,010
その他	9,141,594	10,436,707
固定負債合計	40,059,730	37,335,067
負債合計	98,949,950	102,525,385
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,702,650	18,546,950
資本剰余金	27,571,266	36,516,866
利益剰余金	18,221,662	34,820,556
自己株式	△86,644	△87,496
株主資本合計	63,408,935	89,796,876
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	318,207	488,139
繰延ヘッジ損益	△8,485	—
為替換算調整勘定	3,456,373	7,780,708
退職給付に係る調整累計額	△81,237	△62,188
その他の包括利益累計額合計	3,684,857	8,206,659
新株予約権	81,458	53,336
非支配株主持分	11,064,445	26,823,535
純資産合計	78,239,696	124,880,407
負債純資産合計	177,189,647	227,405,793

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
売上高	41,595,106	59,826,183
売上原価	27,496,596	37,587,526
売上総利益	14,098,509	22,238,657
販売費及び一般管理費	10,185,396	11,505,180
営業利益	3,913,113	10,733,476
営業外収益		
受取利息	22,252	134,564
補助金収入	417,470	347,718
持分法による投資利益	409,809	—
為替差益	—	1,503,484
その他	203,869	297,756
営業外収益合計	1,053,402	2,283,524
営業外費用		
支払利息	768,421	349,884
持分法による投資損失	—	14,607
為替差損	1,187,912	—
その他	185,347	159,299
営業外費用合計	2,141,682	523,791
経常利益	2,824,832	12,493,210
特別利益		
固定資産売却益	—	12,875
持分変動利益	—	9,327,108
特別利益合計	—	9,339,984
特別損失		
固定資産処分損	—	109,134
減損損失	1,079,342	—
事業撤退損	—	927,308
その他	—	126,035
特別損失合計	1,079,342	1,162,477
税金等調整前四半期純利益	1,745,490	20,670,716
法人税等	1,556,634	3,056,682
四半期純利益	188,855	17,614,034
非支配株主に帰属する四半期純利益	117,941	345,331
親会社株主に帰属する四半期純利益	70,913	17,268,702



(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
四半期純利益	188,855	17,614,034
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	113,398	174,195
為替換算調整勘定	△471,540	3,609,870
退職給付に係る調整額	11,999	9,638
持分法適用会社に対する持分相当額	△12,381	1,411,703
その他の包括利益合計	△358,524	5,205,407
四半期包括利益	△169,668	22,819,441
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△239,716	21,483,179
非支配株主に係る四半期包括利益	70,048	1,336,261

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,745,490	20,670,716
減価償却費	4,605,252	3,771,012
減損損失	1,079,342	—
のれん償却額	25,521	58,018
株式報酬費用	37,405	167,169
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,295	168,481
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1,800	△18,300
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△17,596	21,395
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△13,559	791
受取利息及び受取配当金	△26,772	△139,760
支払利息	768,421	349,884
為替差損益 (△は益)	714,673	△1,199,241
持分法による投資損益 (△は益)	△409,809	14,607
固定資産処分損益 (△は益)	—	96,258
持分変動損益 (△は益)	—	△9,327,108
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,853,300	△2,737,373
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,241,804	△3,523,758
仕入債務の増減額 (△は減少)	66,297	1,800,718
その他	4,540,848	△1,598,720
小計	7,024,506	8,574,788
利息及び配当金の受取額	55,271	172,083
利息の支払額	△704,683	△342,686
法人税等の支払額	△845,352	△2,034,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,529,740	6,369,969
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△10,108,409	△13,814,369
有形固定資産の売却による収入	171,010	351,775
無形固定資産の取得による支出	△28,000	△84,530
無形固定資産の売却による収入	—	18,023
投資有価証券の取得による支出	△730	△201,213
貸付けによる支出	△306	—
貸付金の回収による収入	1,120	5,517,998
その他	△1,515	△14,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,966,831	△8,226,444

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	1,682,418	114,810
長期借入れによる収入	9,488,319	1,707,299
長期借入金の返済による支出	△5,614,668	△3,666,953
リース債務の返済による支出	△96,000	△68,294
社債の発行による収入	492,710	—
社債の償還による支出	△1,684,000	△1,434,000
株式の発行による収入	—	84,129
非支配株主からの払込みによる収入	695,784	22,181,918
自己株式の取得による支出	—	△852
配当金の支払額	△444,481	△667,874
非支配株主への配当金の支払額	—	△18,445
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	11,354,788	43,106
その他	△208	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,874,662	18,274,842
現金及び現金同等物に係る換算差額	△265,822	1,588,825
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	11,171,748	18,007,192
現金及び現金同等物の期首残高	23,709,139	30,202,819
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,880,888	48,210,012

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第2四半期連結累計期間において、連結子会社である江蘇富樂徳半導体科技有限公司及び寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司が第三者割当増資を実施したため、資本剰余金が7,973,292千円増加しました。

また、転換社債型新株予約権付社債の転換に伴い、資本金が724,128千円、資本剰余金が724,128千円それぞれ増加しました。

この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が18,546,950千円、資本剰余金が36,516,866千円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、国外の販売については、履行義務は主に運送人引き渡し時点で充足されるため、当該時点において収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	28,784,912	7,116,493	35,901,405	5,693,700	41,595,106	—	41,595,106
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	48,705	—	48,705	377,037	425,743	△425,743	—
計	28,833,617	7,116,493	35,950,111	6,070,738	42,020,849	△425,743	41,595,106
セグメント利益	2,177,407	1,867,757	4,045,164	344,846	4,390,010	△476,897	3,913,113

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△476,897千円には、セグメント間取引の消去448,884千円、各報告セグメントに配分していない全社費用28,013千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「その他」セグメントにおいて1,079,342千円の減損損失を計上しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	35,895,003	12,213,510	48,108,513	11,717,670	59,826,183	—	59,826,183
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	35,895,003	12,213,510	48,108,513	11,717,670	59,826,183	—	59,826,183
セグメント利益	7,104,135	3,052,616	10,156,752	700,319	10,857,072	△123,595	10,733,476

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△123,595千円には、セグメント間取引の消去△32,423千円、各報告セグメントに配分していない全社費用156,019千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメントにおいて、減損損失256,610千円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。